

Schichten: 2

Material: FR4

Fertige Stärke: 1,57 mm +V-10 %

Äußere Schicht Kupfer Dicke: 1 Unze

Abgang: ENIG (Au:2-5u \")

Lötmaske (Farbe): Beide Seiten, LPI (schwarz)

Siebdruck (Farbe): Beide Seiten, weiß

### **Elektrischer test**

ABGANG: DIESES BOARD WERDEN CHEMISCH GOLD PLATTIERT NACH IPC-6012.

Dicke werden .050uM über 3-6uM NICKEL.

KUPFERPLATTE LÖCHER MINDESTENS.025 AVG,.020 MIN... LÖCHER KÖNNEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN, AUßER VIAS.500 FINISH ODER KLEINER.

### **Layer-Schlüssel:**

=====

\*. GM4: Board Outline

\*. TXT: NC-Drill-Datei

\*. GTP: Oben einfügen

\*. GTO: Top Siebdruck

\*. GTS: Top Lötmaske

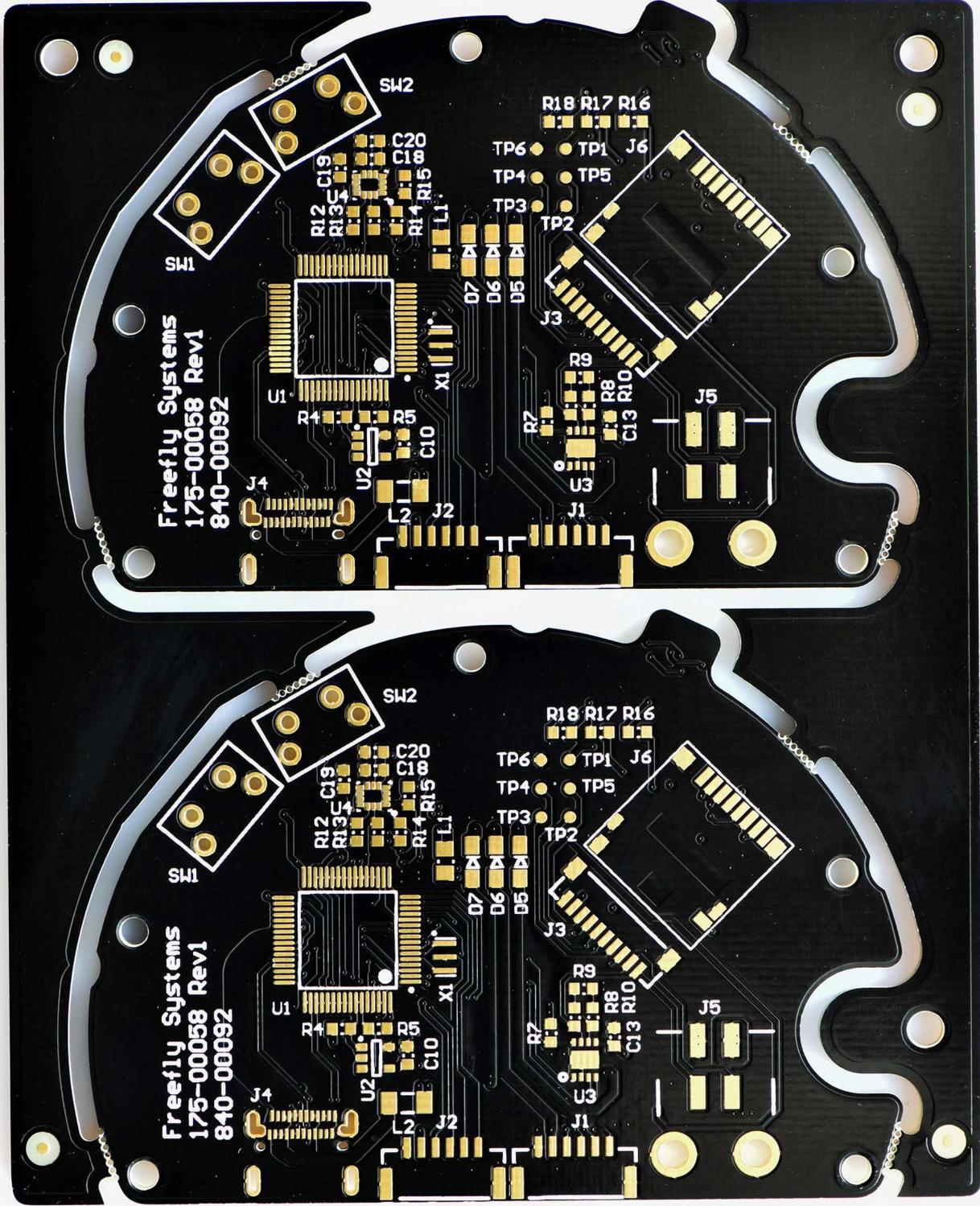
\*. GTL: Kupfer-Deckschicht

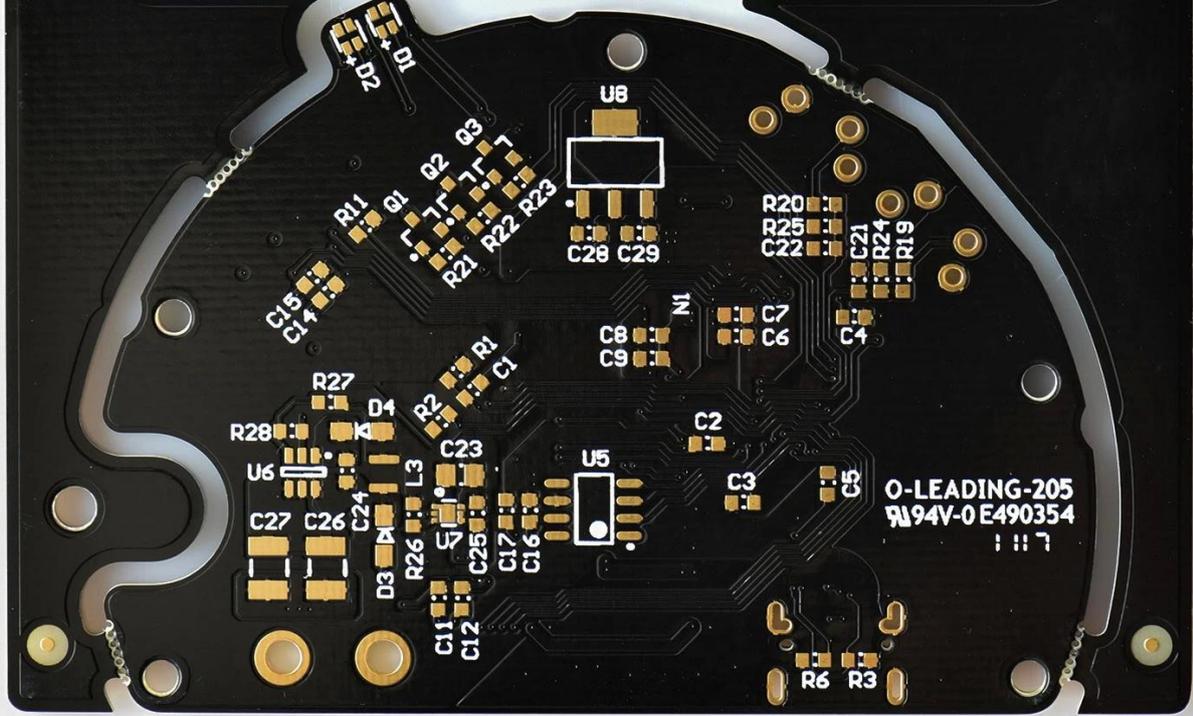
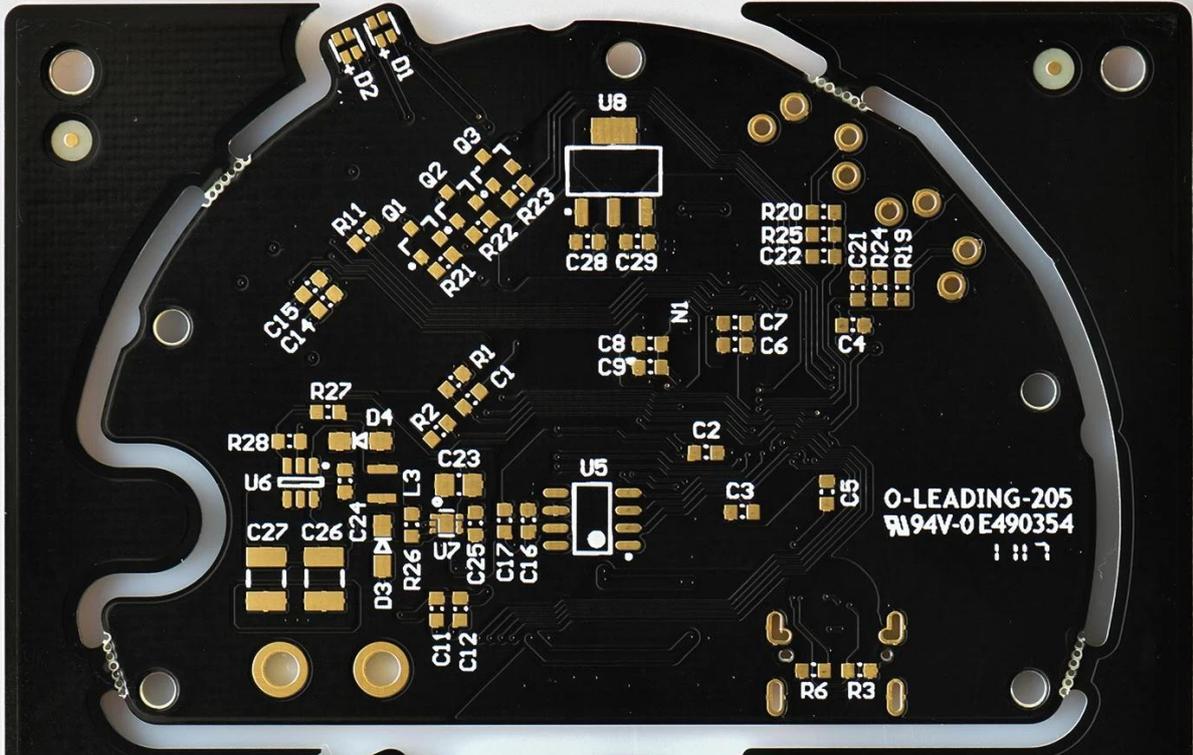
\*. GBL: Untere Kupferschicht

\*. GBS: Unten Lötmaske

\*. GBO: Unten Siebdruck

\*. GBP: Unten einfügen





Doppelseitige Leiterplatten Lieferant, gelb Siebdruck pcb Lieferant